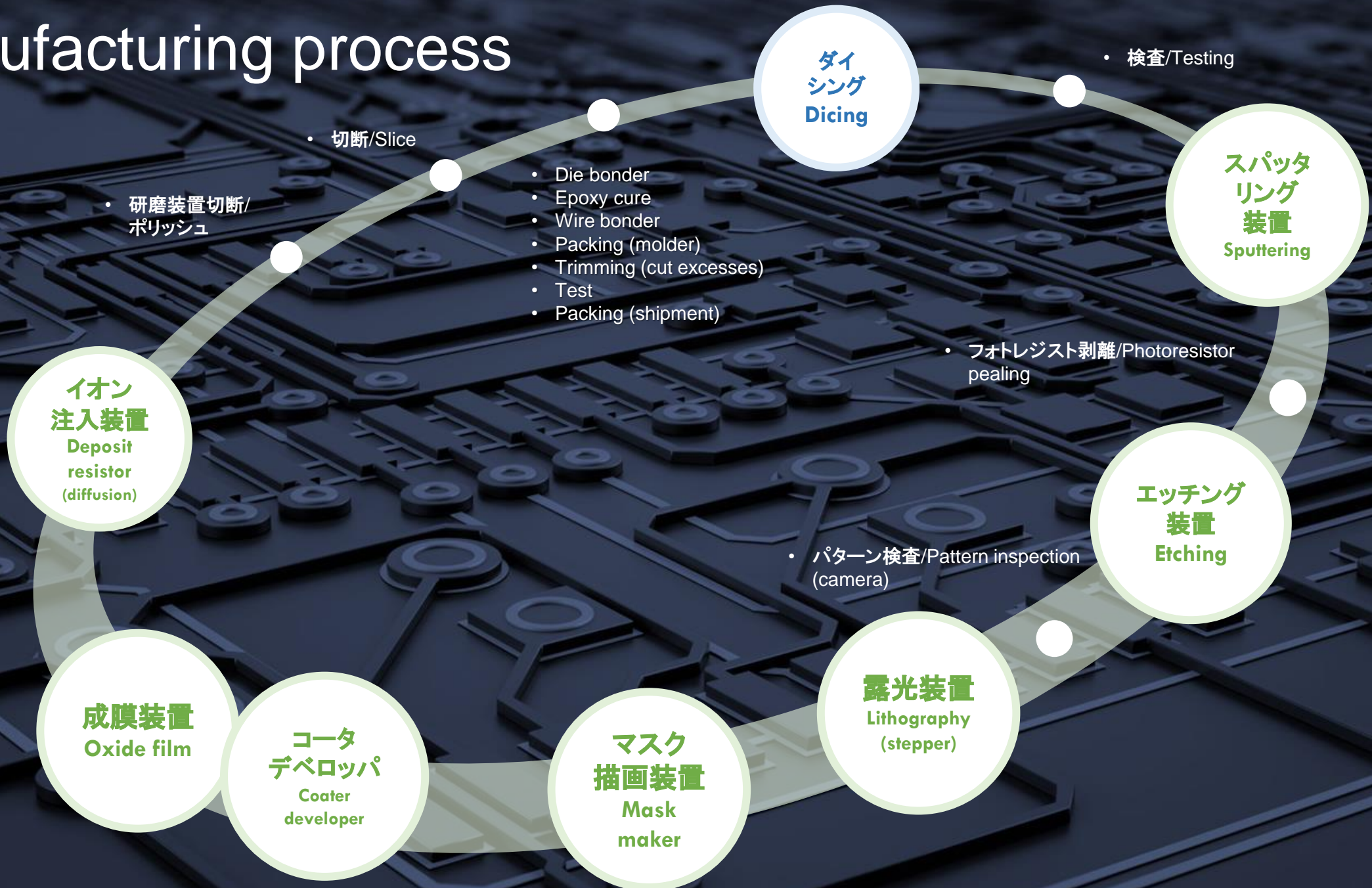


# Semiconductor Industry LEMO Connecting solution



# Manufacturing process



イオン  
注入装置  
Deposit resistor  
(diffusion)

マスク  
描画装置  
Mask maker

ダイ  
シング  
Dicing

スパッタ  
リング  
装置  
Sputtering

成膜装置  
Oxide film

コータ  
デベロッパ  
Coater developer

露光装置  
Lithography (stepper)

エッチング  
装置  
Etching

レモコネクタが採用

## アプリケーション

- ・ 中電流イオン注入装置
- ・ 高電流イオン注入装置
- ・ 高エネルギーイオン注入装置
- ・ 高電流イオン注入装置
- ・ 熱処理装置
- ・ 液体材料気化システム MV-2000 Series
- ・ 液体デジタルマスフローメータ XF-100 Series
- ・ セラミックヒーター



高温



小型



高電圧



プッシュプル



カスタム



気密



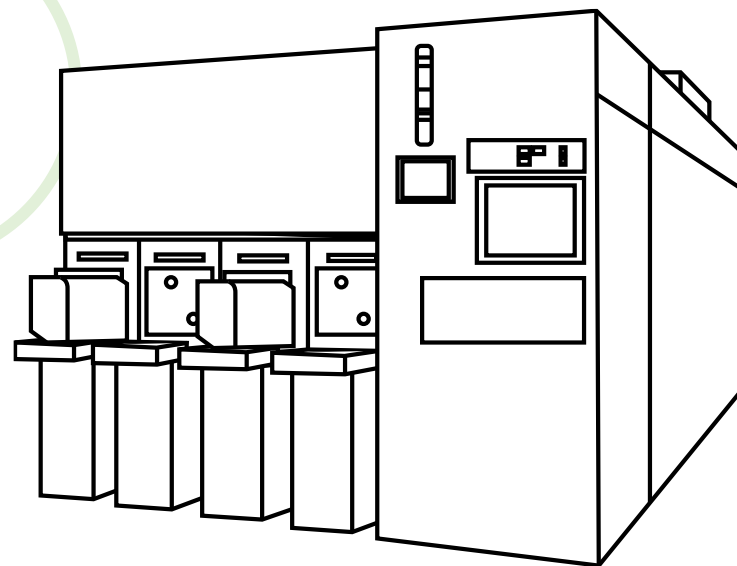
高密度



熱電対

## イオン 注入装置

Deposit  
-resistor  
(diffusion)



# HORIBA

液体材料気化システム  
MV-2000 Series

液体デジタルマスフローメータ  
XF-100 Series

## アプリケーション

- 枚葉プラズマCVD装置
- 熱処理装置
- セラミックヒーター
- 静電チャック



熱電対



高電圧



プッシュプル



カスタム



気密

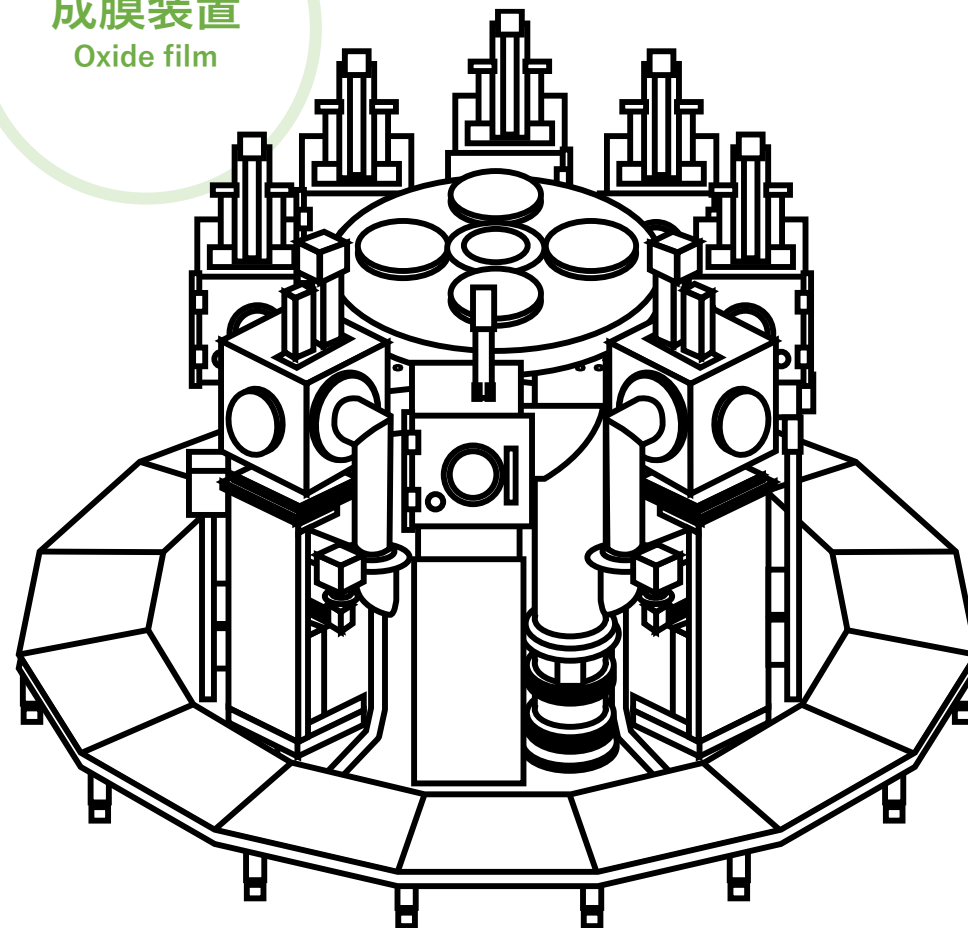


高密度



高温

成膜装置  
Oxide film

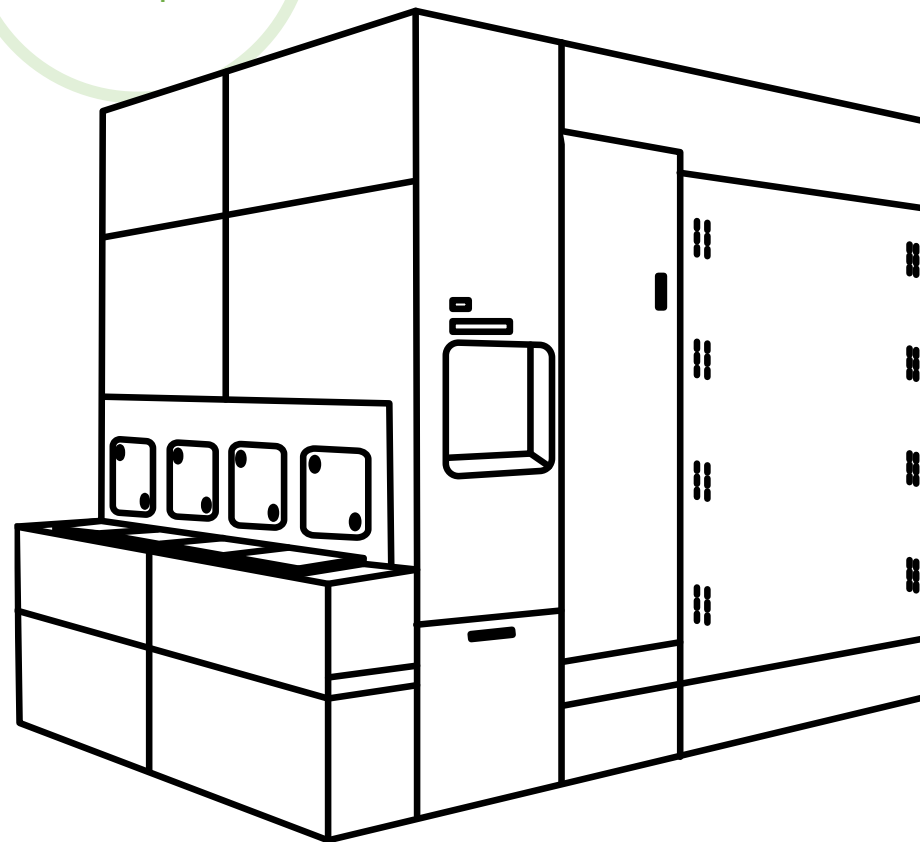


## アプリケーション

- コータ/デベロッパ



コータ  
デベロッパ  
Coater  
developer

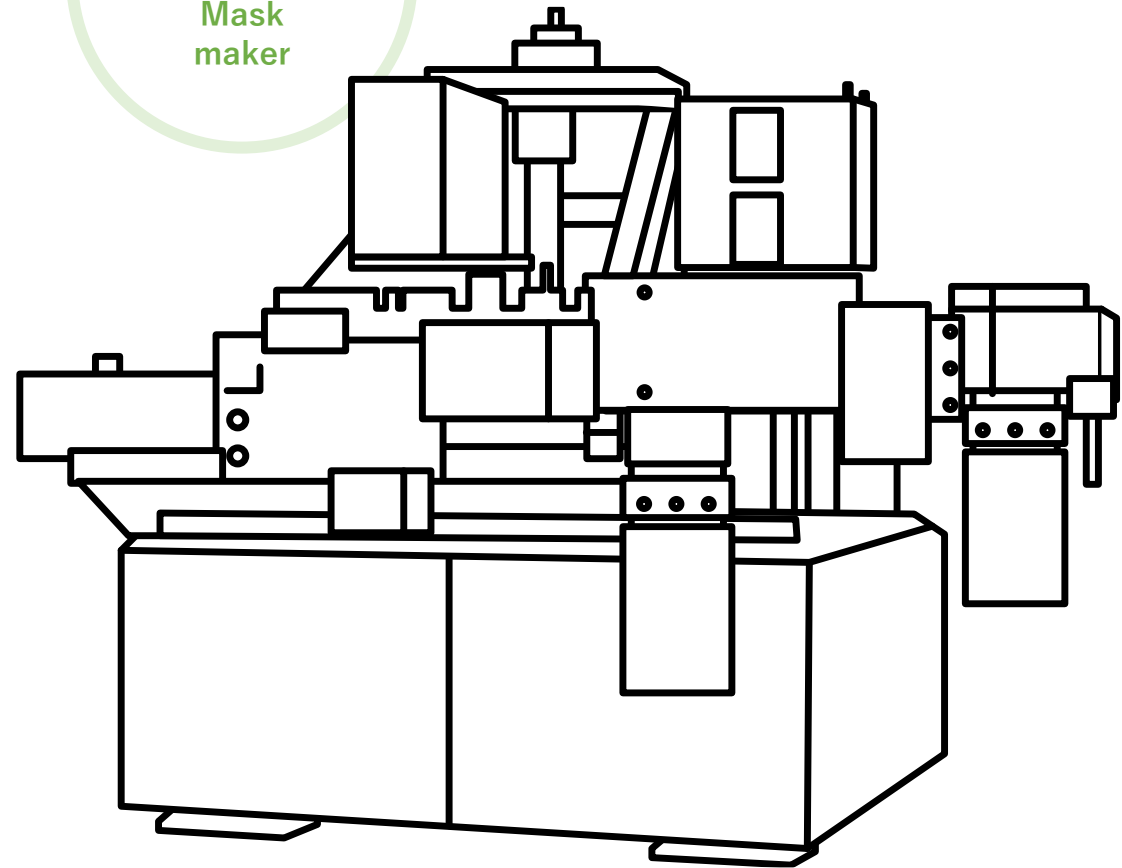


## アプリケーション

- 電子ビーム描画装置
- 電子ビームマスク描画装置
- マスク欠陥検査装置 (SEM)
- 電子線描画装置



マスク  
描画装置  
Mask  
maker



## アプリケーション

- センサー
- アクチュエーター
- ピエゾ
- ポジショニング
- 電子ビーム露光装置



ガス



小型



カスタム



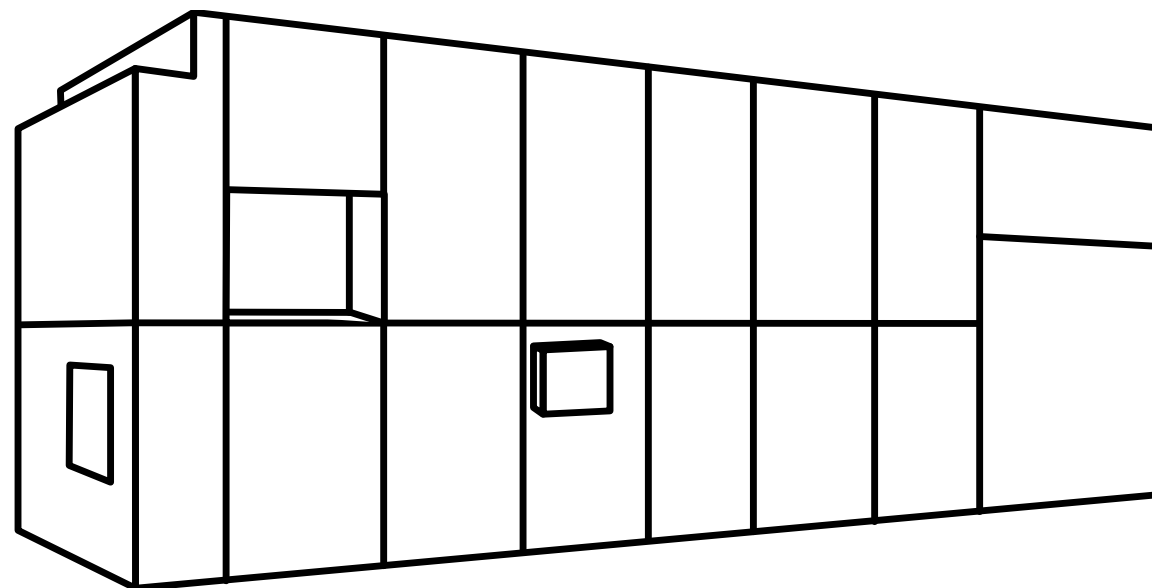
高電圧



気密

## 露光装置

Lithography  
(stepper)





## アプリケーション

- 温度センサー
- 静電チャック
- 分光器



小型



高電圧



カスタム

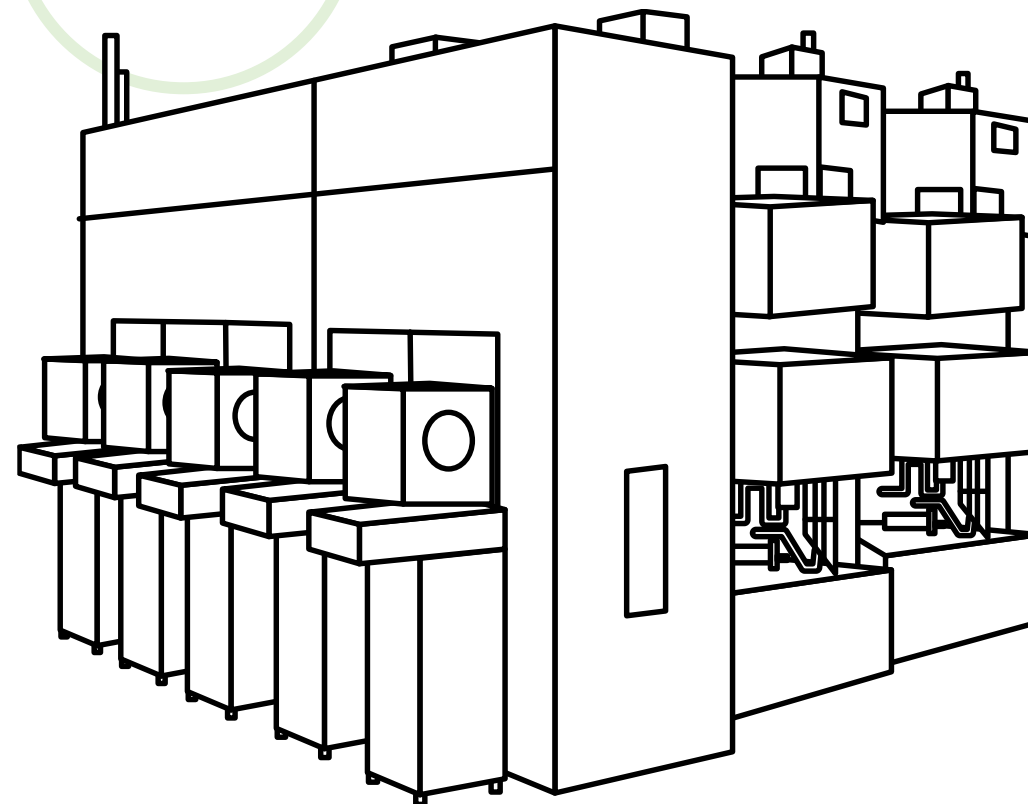


高密度



熱電対

エッチング  
装置  
Etching

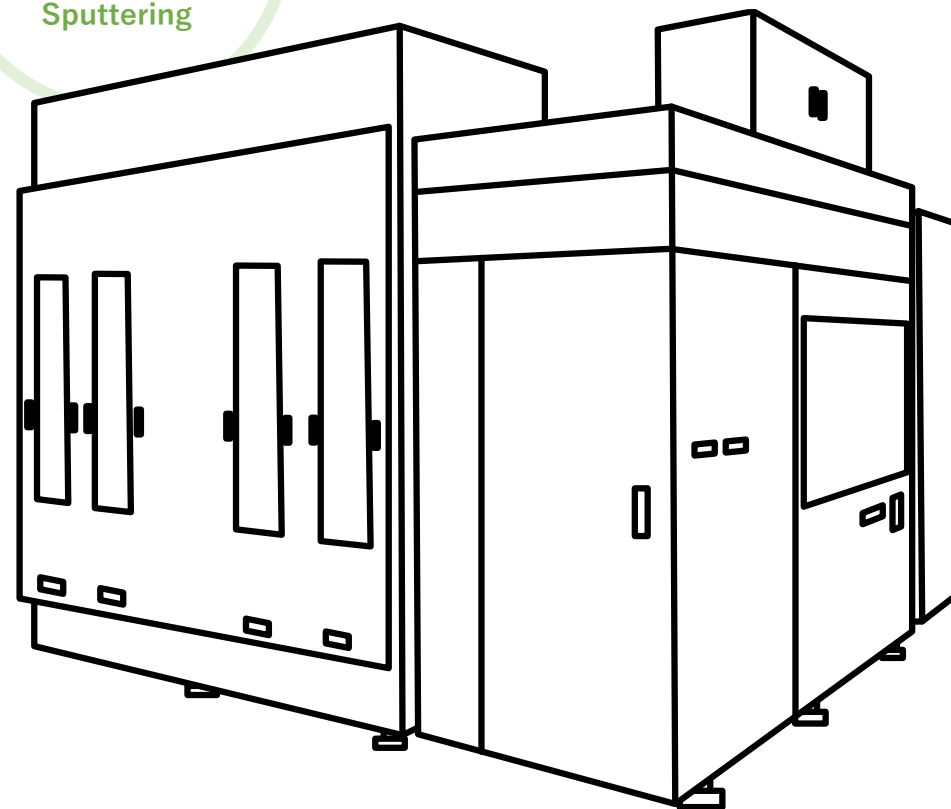


## アプリケーション

- 静電チャック
- ウェハ搬送ロボット

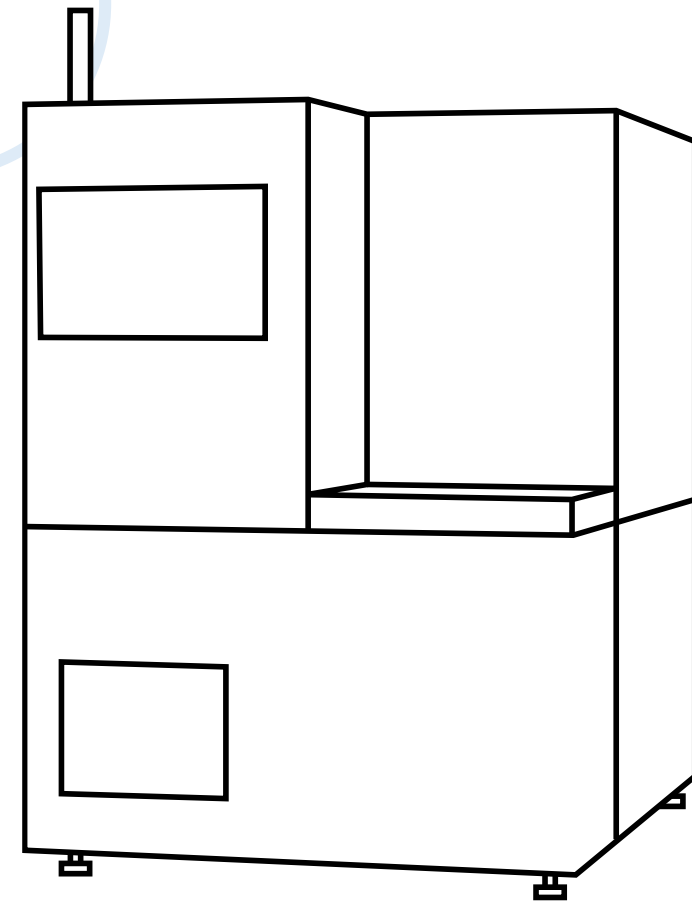


スパッタ  
リング  
装置  
Sputtering

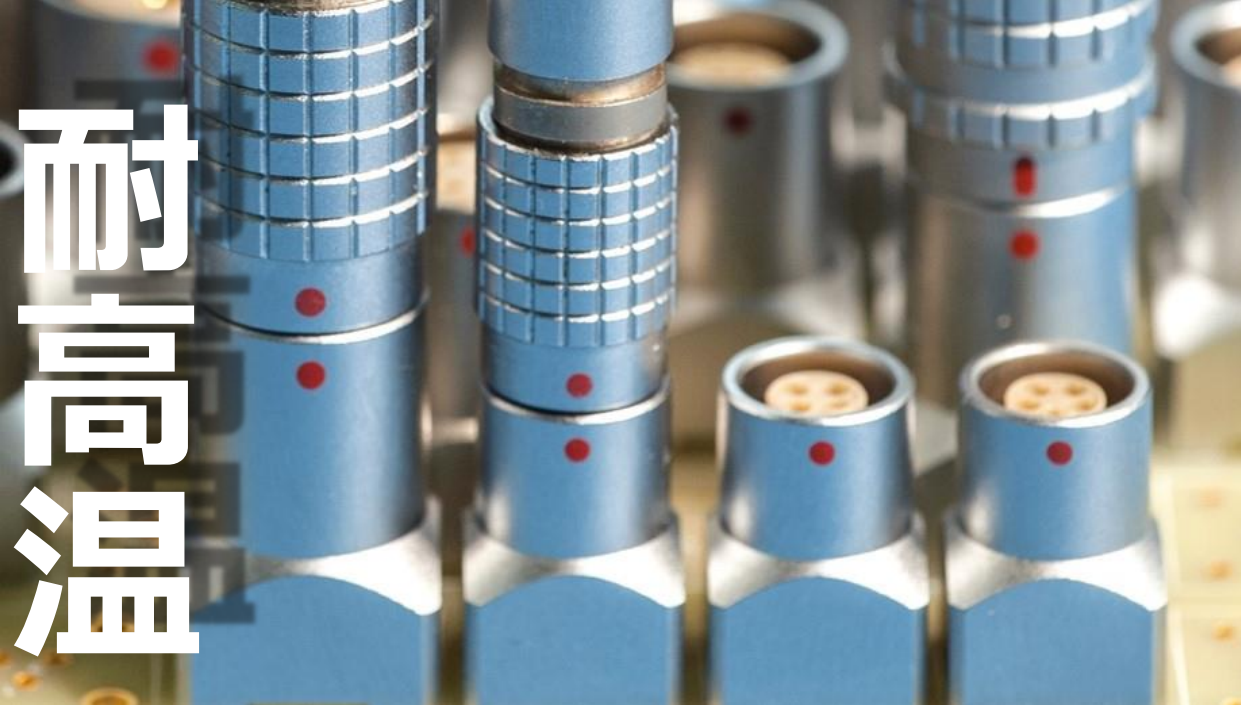


## アプリケーション

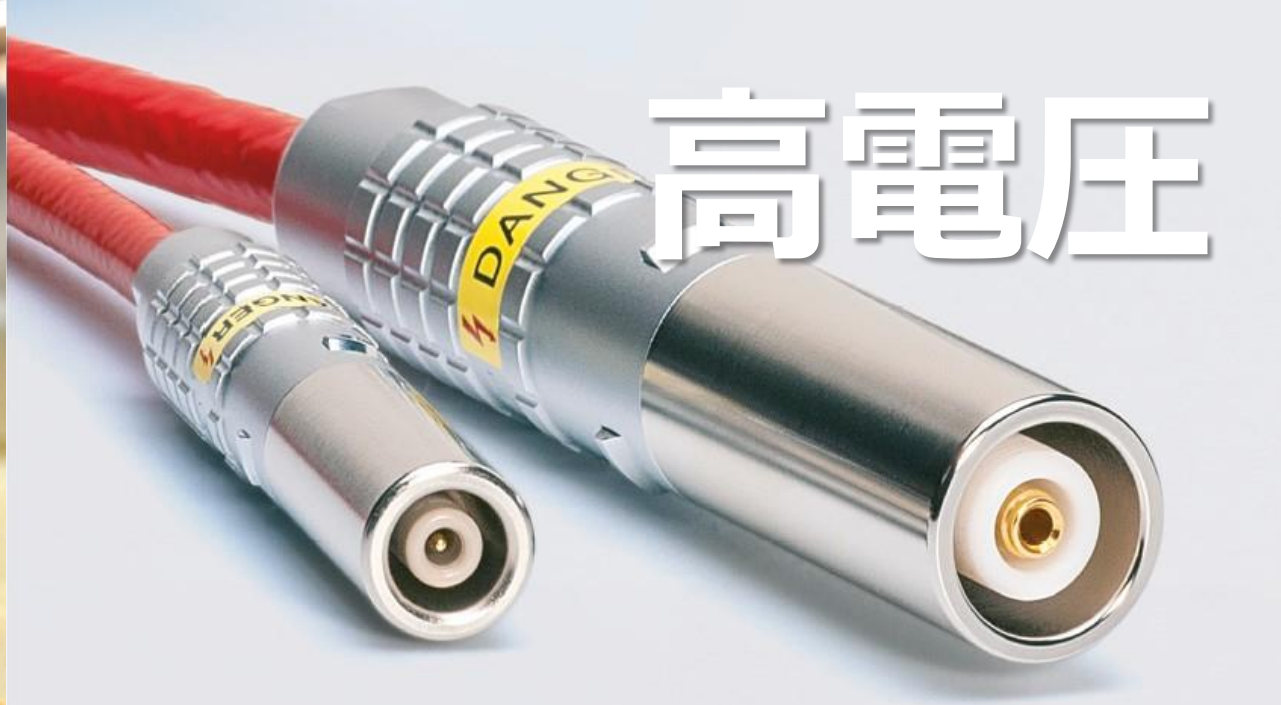
- ・ ダイシング



耐  
高  
溫



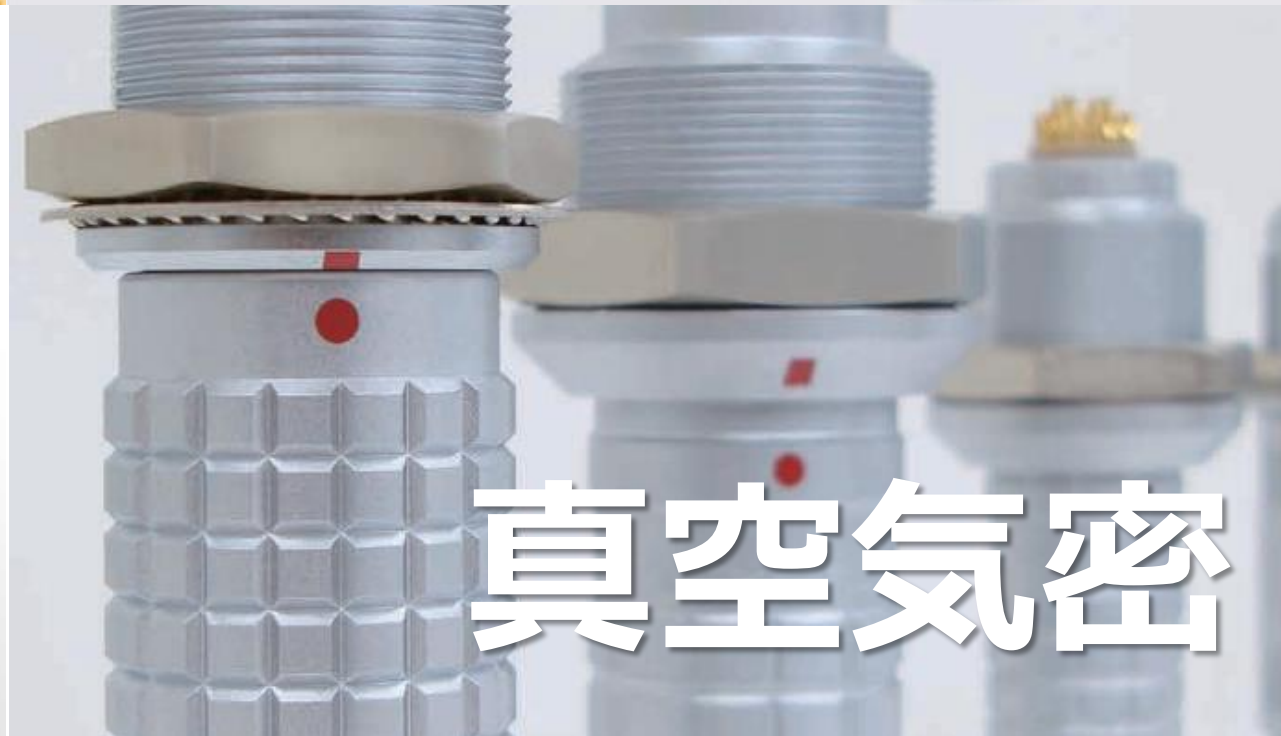
高電壓



小型高密度



真空氣密



# 耐高温コネクタソリューション

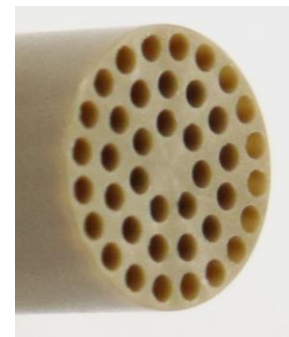
Connector solution



耐熱シリーズ  
コネクタ+250°C  
(気密ver.200°C)  
ケーブル+300°C



+ Northwire 300°C PTFEケーブル付き  
+ 気密シールフィールドスルー固定ソケット



## Key Technologies

レモの技術的特徴

- PEEK絶縁体
- 硬質樹脂による気密封止  
(耐熱 80°C MAX)
- ガラス封止  
(耐熱200°C MAX、カスタム設計)

# 高電圧コネクタソリューション

Connector solution

## 最大 50kVDC



- シールド有小型コネクタ
- 最大50kVDC
- 多極 ~21極
- 真空隔壁用気密封止型固定ソケットあり
- 専用HVケーブルとのSetで提案可能
- 高電圧ケーブル(UL 対応品有り)

## Key Technologies

レモの技術的特徴

- PTFE/Silicon/ PEEK絶縁体
- 高精度に切削されたコネクタボディにより簡単確実にクリック感を得られるプッシュプルコネクタ
- プッシュプルコネクタにより挿抜動作に必要なスペースを極小化



# 小型高密度コネクタソリューション

## Connector solution

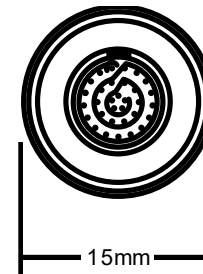


多極コネクタ  
最大 114極

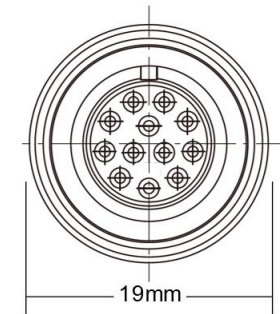
- + 他社汎用コネクタ比較で2.5倍高密度
- + ブラインドメーティング
- + 熱電対ピン組込み可能（温度計測用）
- + 真空隔壁用気密封止型固定ソケット

## Key Technologies

レモの技術的特徴



Φ 15  
32極  
(max)



Φ 19  
20極  
(max)

# 真空気密リユーション

## Connector solution

主要  
単極・多極・同軸  
186種

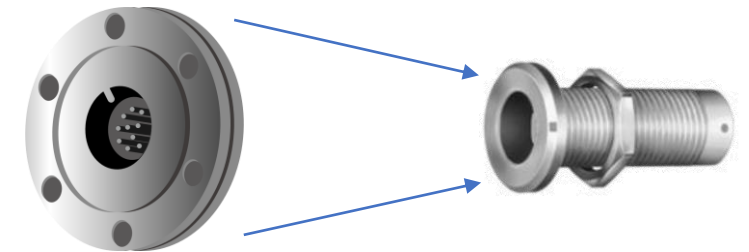


- He漏れ率  $1 \times 10^{-8} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{sec}$
- 温度範囲  $-20 \sim 100^\circ\text{C}$  (~1B/1Sサイズ)  
 $-20 \sim 80^\circ\text{C}$  (2B/2Sサイズ~)

## Key Technologies

レモの技術的特徴

- PEEK絶縁体
- 硬質樹脂による気密封止 (耐熱  $80^\circ\text{C}$  MAX)
- ガラス封止 (耐熱  $200^\circ\text{C}$  MAX、カスタム設計)



他社製 約  $\phi 40$ /12極

 **LEMO**  $\phi 17$ /12極



# Semiconductor Industry LEMO Connecting solution



レモジャパン株式会社  
〒108-0073 東京都港区三田2-7-22

HP : [lemo.co.jp](http://lemo.co.jp) チャット受付中！公式Twitter : @lemojapan